

100-2 大葉大學 選課版課綱

基本資訊

| | | | |
|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 課程名稱 | 電子封裝概論 | 科目序號 / 代號 | 1143 / MAV4020 |
| 開課系所 | 機械與自動化工程學系 | 學制 / 班級 | 四技部4年1班 |
| 任課教師 | 鄭江河 | 專兼任別 | 專任 |
| 必選修 / 學分數 | 選修 / 3 | 畢業班 / 非畢業班 | 畢業班 |
| 上課時段 / 地點 | (二)56 / H440 (三)9 / H440 | 授課語言別 | 中文 |

課程簡介

電子封裝是半導體製造產業之後段製程，在本課程除教授傳統的塑膠構裝、陶瓷構裝、捲帶自動接合外，也介紹目前新型構裝技術，如覆晶、球陣列式構裝、晶片形構裝及異方性導電膠。

課程大綱

- 1 前言
- 2 聯線技術
- 3 塑膠構裝
- 4 陶瓷構裝
- 5 薄/厚膜技術
- 6 捲帶自動接合
- 7 覆晶接合
- 8 異方性導電膠
- 9 新型構裝技術

基本能力或先修課程

半導體製程、微機電系統概論